

中国高端芯片行业前景预测及投资商机分析报告2023-2030年

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 中国高端芯片行业前景预测及投资商机分析报告 2023-2030年 |
| 公司名称 | 鸿晟信合研究网 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530) |
| 联系电话 | 18513627985 18513627985 |

产品详情

中国高端芯片行业前景预测及投资商机分析报告2023-2030年

【全新修订】：2023年11月

【出版机构】：中赢信合研究网

【内容部分有删减·详细可参中赢信合研究网出版完整信息！】

【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)

【服务形式】：文本+电子版+光盘

【联系人】：何晶晶 顾佳

免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员

章 高端芯片行业相关概述

1.1 芯片相关介绍

1.1.1 基本概念

1.1.2 摩尔定律

1.1.3 芯片分类

1.1.4 产业链条

1.1.5 商业模式

1.2 高端芯片相关概述

1.2.1 高端概念界定

1.2.2 逻辑芯片

1.2.3 存储芯片

1.2.4 模拟芯片

1.2.5 芯片进程发展

第二章 2021-2023年国际高端芯片行业发展综合分析

2.1 2021-2023年全球芯片行业发展情况分析

2.1.1 全球经济形势分析

2.1.2 全球芯片销售规模

2.1.3 全球芯片区域市场

2.1.4 全球芯片产业分布

2.1.5 全球芯片细分市场

2.1.6 全球芯片需求现状

2.1.7 全球芯片重点企业

2.2 2021-2023年全球高端芯片行业现况分析

2.2.1 高端芯片市场现状

2.2.2 高端逻辑芯片市场

2.2.3 高端存储芯片市场

2.3 2021-2023年美国高端芯片行业发展分析

2.3.1 美国芯片发展现状

2.3.2 美国芯片市场结构

2.3.3 美国主导芯片供应

2.3.4 美国芯片相关政策

2.4 2021-2023年韩国高端芯片行业发展分析

2.4.1 韩国芯片发展现状

2.4.2 韩国芯片市场分析

2.4.3 韩国芯片发展问题

2.4.4 韩国芯片发展经验

2.5 2021-2023年日本高端芯片行业发展分析

2.5.1 日本芯片市场现状

2.5.2 日本芯片竞争优势

2.5.3 日本芯片国家战略

2.5.4 日本芯片发展经验

2.6 2021-2023年中国台湾高端芯片行业发展分析

2.6.1 中国台湾芯片发展现状

2.6.2 中国台湾芯片市场规模

2.6.3 中国台湾芯片产业链布局

2.6.4 台湾与大陆产业优势互补

2.6.5 美国对台湾芯片发展影响

第三章 2021-2023年中国高端芯片行业发展环境分析

3.1 政策环境

3.1.1 智能制造行业政策

3.1.2 行业监管主体部门

3.1.3 行业相关政策汇总

3.1.4 集成电路税收政策

3.2 经济环境

3.2.1 宏观经济概况

3.2.2 对外经济分析

3.2.3 工业经济运行

3.2.4 固定资产投资

3.2.5 宏观经济展望

3.2.6 中美科技战影响

3.3 投融资环境

3.3.1 美方制裁加速投资

3.3.2 社会资本推动作用

3.3.3 大基金投融资情况

3.3.4 地方政府产业布局

3.3.5 设备资本市场情况

3.4 人才环境

3.4.1 需求现状概况

3.4.2 人才供需失衡

3.4.3 创新人才紧缺

3.4.4 培养机制不健全

第四章 2021-2023年中国高端芯片行业综合分析

4.1 2021-2023年中国芯片行业发展业态

4.1.1 芯片市场发展规模

4.1.2 芯片细分产品业态

4.1.3 芯片设计行业发展

4.1.4 芯片制造行业发展

4.1.5 芯片封测行业发展

4.2 2021-2023年中国高端芯片发展情况

4.2.1 高端芯片行业发展现状

4.2.2 高端芯片细分产品发展

4.2.3 高端芯片技术发展方向

4.3 中国高端芯片行业发展问题

4.3.1 芯片产业核心技术问题

4.3.2 芯片产业生态构建问题

4.3.3 高端芯片资金投入问题

4.3.4 国产高端芯片制造问题

4.4 中国高端芯片行业发展建议

4.4.1 尊重市场发展规律

4.4.2 上下环节全面发展

4.4.3 加强全球资源整合

第五章 2021-2023年高性能CPU行业发展分析

5.1 CPU相关概述

5.1.1 CPU基本介绍

5.1.2 CPU主要分类

5.1.3 CPU的指令集

5.1.4 CPU的微架构

5.2 高性能CPU技术演变

5.2.1 CPU总体发展概述

5.2.2 指令集更新与优化

5.2.3 微架构的升级过程

5.3 CPU市场发展情况分析

5.3.1 产业链条结构分析

5.3.2 全球高端CPU供需分析

5.3.3 国产高端CPU发展现状

5.3.4 国产高端CPU市场前景

5.4 CPU细分市场发展分析

5.4.1 服务器CPU市场

5.4.2 PC领域CPU市场

5.4.3 移动计算CPU市场

5.5 CPU行业代表企业CPU产品业务分析

5.5.1 AMD CPU产品分析

5.5.2 英特尔CPU产品分析

5.5.3 苹果CPU产品分析

第六章 2021-2023年高性能GPU行业发展分析

6.1 GPU基本介绍

6.1.1 GPU概念阐述

6.1.2 GPU的微架构

6.1.3 GPU的API介绍

6.1.4 GPU显存介绍

6.1.5 GPU主要分类

6.2 高性能GPU演变分析

6.2.1 GPU技术发展历程

6.2.2 GPU微架构进化过程

6.2.3 先进制造升级历程

6.2.4 主流高端GPU发展

6.3 高性能GPU市场分析

6.3.1 GPU产业链条分析

6.3.2 全球GPU发展现状

6.3.3 全球供需情况概述

6.3.4 国产GPU发展情况

6.3.5 国内GPU企业布局

6.3.6 国内高端GPU研发

6.4 GPU细分市场分析

6.4.1 服务器GPU市场

6.4.2 移动电子GPU市场

6.4.3 PC领域GPU市场

6.4.4 AI领域GPU芯片市场

6.5 高性能GPU行业代表企业产品分析

6.5.1 英伟达GPU产品分析

6.5.2 AMD GPU产品分析

6.5.3 英特尔GPU产品分析

第七章 2021-2023年FPGA芯片行业发展综述

7.1 FPGA芯片概况综述

7.1.1 定义及物理结构

7.1.2 芯片特点与分类

7.1.3 不同芯片的区别

7.1.4 FPGA技术分析

7.2 FPGA芯片行业产业链分析

7.2.1 FPGA市场上游分析

7.2.2 FPGA市场中游分析

7.2.3 FPGA市场下游分析

7.3 全球FPGA芯片市场发展分析

7.3.1 FPAG市场发展现状

7.3.2 FPGA全球竞争情况

7.3.3 AI领域FPGA的发展

7.3.4 FPGA芯片发展趋势

7.4 中国FPGA芯片市场发展分析

7.4.1 中国FPGA市场规模

7.4.2 中国FPGA竞争格局

7.4.3 中国FPGA企业现状

第八章 2021-2023年存储芯片行业发展分析

8.1 存储芯片发展概述

8.1.1 存储芯片定义及分类

8.1.2 存储芯片产业链构成

8.1.3 存储芯片技术发展

8.2 存储芯片市场发展情况分析

8.2.1 存储芯片行业驱动因素

8.2.2 全球存储芯片发展规模

8.2.3 中国存储芯片销售规模

8.2.4 国产存储芯片发展现状

8.2.5 存储芯片行业发展趋势

8.3 高端DRAM芯片市场分析

8.3.1 高端DRAM概念界定

8.3.2 DRAM芯片产品分类

8.3.3 DRAM芯片应用领域

8.3.4 DRAM芯片市场现状

8.3.5 DRAM市场需求态势

8.3.6 企业高端DRAM布局

8.3.7 高端DRAM工艺发展

8.3.8 国产DRAM研发动态

8.3.9 DRAM技术发展潜力

8.4 高性能NAND Flash市场分析

8.4.1 NAND Flash概念

8.4.2 NAND Flash技术路线

8.4.3 NAND Flash市场发展规模

8.4.4 NAND Flash市场竞争情况

8.4.5 NAND Flash需求业态分析

8.4.6 高端NAND Flash研发热点

8.4.7 国内NAND Flash代表企业

第九章 2021-2023年人工智能芯片行业发展分析

9.1 人工智能芯片概述

9.1.1 人工智能芯片分类

9.1.2 人工智能芯片主要类型

9.1.3 人工智能芯片对比分析

9.1.4 人工智能芯片产业链

9.2 人工智能芯片行业发展情况

9.2.1 全球AI芯片市场规模

9.2.2 国内AI芯片发展现状

9.2.3 国内AI芯片主要应用

9.2.4 国产AI芯片厂商分布

9.2.5 国内主要AI芯片厂商

9.3 人工智能芯片在汽车行业应用分析

9.3.1 AI芯片智能汽车应用

9.3.2 车规级芯片标准概述

9.3.3 汽车AI芯片市场格局

9.3.4 汽车AI芯片国外企业

9.3.5 汽车AI芯片国内企业

9.3.6 智能座舱芯片发展

9.3.7 自动驾驶芯片发展

9.4 云端人工智能芯片发展解析

9.4.1 云端AI芯片市场需求

9.4.2 云端AI芯片主要企业

9.4.3 互联网企业布局分析

9.4.4 云端AI芯片发展动态

9.5 边缘人工智能芯片发展情况

9.5.1 边缘AI使用场景

9.5.2 边缘AI芯片市场需求

9.5.3 边缘AI芯片市场现状

9.5.4 边缘AI芯片主要企业

9.5.5 边缘AI芯片市场前景

9.6 人工智能芯片行业未来发展趋势

9.6.1 AI芯片未来技术趋势

9.6.2 边缘智能芯片市场机遇

9.6.3 终端智能计算能力预测

9.6.4 智能芯片一体化生态发展

第十章 2021-2023年5G芯片行业发展分析

10.1 5G芯片行业发展分析

10.1.1 5G芯片分类

10.1.2 5G芯片产业链

10.1.3 5G芯片发展历程

10.1.4 5G芯片市场需求

10.1.5 5G芯片行业现状

10.1.6 5G芯片市场竞争

10.1.7 5G芯片企业布局

10.2 5G基带芯片市场发展情况

10.2.1 基带芯片基本定义

10.2.2 基带芯片组成部分

10.2.3 基带芯片基本架构

10.2.4 基带芯片市场现状

10.2.5 基带芯片竞争现状

10.2.6 国产基带芯片发展

10.3 5G射频芯片市场发展情况

10.3.1 射频芯片基本介绍

10.3.2 射频芯片组成部分

10.3.3 射频芯片发展现状

10.3.4 射频芯片企业布局

10.3.5 射频芯片研发动态

10.3.6 射频芯片技术壁垒

10.3.7 射频芯片市场空间

10.4 5G物联网芯片市场发展情况

10.4.1 物联网芯片重要地位

10.4.2 5G时代物联网通信

10.4.3 5G物联网芯片布局

10.5 5G芯片产业未来发展前景分析

10.5.1 5G行业趋势分析

10.5.2 5G芯片市场趋势

10.5.3 5G芯片应用前景

第十一章 2021-2023年光通信芯片行业发展分析

11.1 光通信芯片相关概述

11.1.1 光通信芯片介绍

11.1.2 光通信芯片分类

11.1.3 光通信芯片产业链

11.2 光通信芯片产业发展情况

11.2.1 光通信芯片产业发展现状

11.2.2 光通信芯片技术发展态势

11.2.3 光通信芯片产业主要企业

11.2.4 高端光通信芯片竞争格局

11.2.5 高端光通信芯片研发动态

11.3 光通信芯片行业投融资潜力分析

11.3.1 行业投融资情况

11.3.2 行业项目投资案例

11.3.3 行业项目投资动态

11.4 光通信芯片行业发展趋势

11.4.1 国产替代规划

11.4.2 行业发展机遇

11.4.3 行业发展趋势

11.4.4 产品发展趋势

第十二章 2021-2023年其他高端芯片市场发展分析

12.1 高精度ADC芯片市场分析

12.1.1 ADC芯片概述

12.1.2 ADC芯片技术分析

12.1.3 ADC芯片设计架构

12.1.4 ADC芯片市场需求

12.1.5 ADC芯片主要市场

12.1.6 高端ADC芯片市场格局

12.1.7 国产高端ADC芯片发展

12.1.8 高端ADC芯片进入壁垒

12.2 高端MCU芯片市场分析

12.2.1 MCU芯片发展概况

12.2.2 MCU芯片市场规模

12.2.3 MCU芯片竞争格局

12.2.4 国产高端MCU芯片发展

12.2.5 智能MCU芯片发展分析

12.3 ASIC芯片市场运行情况

12.3.1 ASIC芯片定义及分类

12.3.2 ASIC芯片应用领域

12.3.3 ASIC芯片技术升级现状

12.3.4 人工智能ASIC芯片应用

第十三章 2021-2023年国际高端芯片行业主要企业运营情况

13.1 高通

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 2021财年企业经营状况分析

13.1.3 2022财年企业经营状况分析

13.1.4 2023财年企业经营状况分析

13.2 三星

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 2021财年企业经营状况分析

13.2.3 2022财年企业经营状况分析

13.2.4 2023财年企业经营状况分析

13.3 英特尔

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 2021财年企业经营状况分析

13.3.3 2022财年企业经营状况分析

13.3.4 2023财年企业经营状况分析

13.4 英伟达

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 2021财年企业经营状况分析

13.4.3 2022财年企业经营状况分析

13.4.4 2023财年企业经营状况分析

13.5 AMD

13.5.1 企业发展概况

13.5.2 2021财年企业经营状况分析

13.5.3 2022财年企业经营状况分析

13.5.4 2023财年企业经营状况分析

13.6 联发科

13.6.1 企业发展概况

13.6.2 2021财年企业经营状况分析

13.6.3 2022财年企业经营状况分析

13.6.4 2023财年企业经营状况分析

第十四章 2020-2023年国内高端芯片行业主要企业运营情况

14.1 海思半导体

14.1.1 企业发展概况

14.1.2 产品发展分析

14.1.3 服务领域分析

14.1.4 企业营收情况

14.2 紫光展锐

14.2.1 企业发展概况

14.2.2 企业主要产品

14.2.3 5G芯片业务发展

14.2.4 手机芯片技术动态

14.3 光迅科技

14.3.1 企业发展概况

14.3.2 经营效益分析

14.3.3 业务经营分析

14.3.4 财务状况分析

14.3.5 核心竞争力分析

14.3.6 公司发展战略

14.3.7 未来前景展望

14.4 寒武纪科技

14.4.1 企业发展概况

14.4.2 经营效益分析

14.4.3 业务经营分析

14.4.4 财务状况分析

14.4.5 核心竞争力分析

14.4.6 公司发展战略

14.4.7 未来前景展望

14.5 盛景微电子

14.5.1 企业发展概况

14.5.2 经营效益分析

14.5.3 业务经营分析

14.5.4 财务状况分析

14.5.5 核心竞争力分析

14.5.6 公司发展战略

14.5.7 未来前景展望

14.6 兆易创新

14.6.1 企业发展概况

14.6.2 经营效益分析

14.6.3 业务经营分析

14.6.4 财务状况分析

14.6.5 核心竞争力分析

14.6.6 公司发展战略

14.6.7 未来前景展望

14.7 高端芯片行业其他重点企业发展

14.7.1 长江存储

14.7.2 燧原科技

14.7.3 翱捷科技

14.7.4 地平线

第十五章 2024-2030年高端芯片行业投融资分析及发展前景预测

15.1 中国高端芯片行业投融资环境

15.1.1 美方制裁加速投资

15.1.2 社会资本推动作用

15.1.3 大基金投融资情况

15.1.4 地方政府产业布局

15.1.5 设备资本市场情况

15.2 中国高端芯片行业投融资分析

15.2.1 高端芯片行业投融资态势

15.2.2 高端芯片行业投融资动态

15.2.3 高端芯片行业投融资趋势

15.2.4 高端芯片行业投融资壁垒

15.3 国际高端芯片行业未来发展趋势

15.3.1 全球高端芯片行业技术趋势

15.3.2 中国高端芯片行业增长趋势

15.3.3 中国高端芯片行业发展前景

15.4 中国高端芯片行业应用市场展望

15.4.1 5G手机市场需求强劲

15.4.2 服务器市场保持涨势

15.4.3 PC电脑市场需求旺盛

15.4.4 智能汽车市场稳步发展

15.4.5 智能家居市场快速发展

图表目录

图表 全球半导体销售规模地域分布

图表 全球半导体细分市场规模

图表 IDM模式IC设计公司份额

图表 全球Fabless芯片设计名

图表 市值100亿美元以上的IC设计公司

图表 韩国从日本进口氟化氢的进口数据

图表 韩国出口到中国集成电路出口额和增长率

图表 韩国集成电路出口数据

图表 全球半导体供应商

图表 主要国家和地区非存储半导体技术水平

图表 晶圆处理设备全球前10强企业

图表 中国大陆芯片企业数量

图表 中国集成电路设计业销售收入

图表 中国集成电路制造销售收入

图表 中国集成电路封装测试业销售收入

图表 英特尔Sandy Bridge处理器核心部分

图表 CPU关键参数

图表 冯若依曼计算机体系

图表 CPU对行业的底层支撑

图表 CPU架构发展情况

图表 台式电脑高端CPU芯片产品及性能

图表 智能手机CPU芯片企业在各区域市场份额

图表 手机高端CPU芯片产品及性能

图表 主流的高端GPU及其所占据市场

图表 全球GPU产业链

图表 中国GPU产业链

图表 2020-2027年全球GPU市场规模预测

图表 全球PC GPU销售市场份额

图表 三大存储器芯片对比

图表 中国存储器芯片全产业链及内资企业布局

图表 中国存储器芯片行业技术发展分析

图表 传统内存处理与物联网内存处理方案对比

图表 2013-2023年全球存储芯片市场规模及预测

图表 中国存储器芯片行业市场规模

图表 2014-2021年DRAM需求供给情况

图表 全球NAND市场规模

图表 各NAND厂商占比情况

图表 全球主要NAND厂商产品对比

图表 国际存储大厂对3D TLC NAND的产品研发

图表 国际存储大厂对3D QLC NAND的产品研发

图表 人工智能芯片分类

图表 传统芯片与智能芯片的特点和异同

图表 AI芯片的主要技术路径

图表 人工智能芯片产业链

图表 2019-2025年全球AI计算芯片市场规模

图表 2019-2025年全球AI计算芯片市场份额

图表 智能语音AI芯片厂商市场占有率

图表 AI视觉各处理器应用情况

图表 AI视觉芯片厂商市场占有率

图表 边缘计算芯片厂商市场占有率

图表 汽车芯片标准远高于消费级

图表 功能安全标准对故障等级要求苛刻

图表 汽车智能驾驶 AI 芯片对比

图表 主流厂商车载计算平台性能参数对比

图表 主要芯片企业云端智能芯片比较

图表 主要芯片企业边缘端智能芯片比较

图表 5G芯片行业产业链分析

图表 5G芯片行业发展历程

图表 5G芯片厂商寡头竞争格局

图表 基带芯片结构图

图表 基带芯片基本架构

图表 射频电路方框图

图表 部分射频器件功能简介

图表 射频前端结构示意图

图表 全球射频前端市场规模

图表 2019-2025年移动终端射频前端及连接市场规模预测

图表 全球射频前端市场竞争格局

图表 射频芯片设计壁垒

图表 半导体是物联网的核心

图表 物联网领域涉及的半导体技术

图表 MMC终端业务类型分类

图表 光通信芯片工作原理

图表 光模块构造图

图表 光通信芯片分类

图表 光芯片产业链结构和代表公司

图表 国外主要厂商激光器芯片量产情况

图表 国内主要厂商激光器芯片量产情况

图表 主要高端光芯片厂商及其主要产品

图表 光芯片行业融资情况

图表 AWG及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目投资概算

图表 AWG及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目实施进度安排

图表 核心光芯片国产替代进程将加速

图表 ADC芯片模块原理

图表 ADC/DAC芯片工作过程

图表 模拟和数字集成电路的区别

图表 中国MCU市场规模

图表 MCU市场集中度

图表 MCU六大应用领域及TOP厂商

图表 2020-2021年高通综合收益表

图表 2020-2021年高通分部资料

图表 2020-2021年高通收入分地区资料

图表 2021-2022年高通综合收益表

图表 2021-2022年高通分部资料

图表 2021-2022年高通收入分地区资料

图表 2022-2023年高通综合收益表

图表 2022-2023年高通分部资料

图表 2022-2023年高通收入分地区资料

图表 2020-2021年三星综合收益表

图表 2020-2021年三星分部资料

图表 2020-2021年三星收入分地区资料

图表 2021-2022年三星综合收益表

图表 2021-2022年三星分部资料

图表 2021-2022年三星收入分地区资料

图表 2022-2023年三星综合收益表

图表 2022-2023年三星分部资料

图表 2022-2023年三星收入分地区资料

图表 2020-2021年英特尔综合收益表

图表 2020-2021年英特尔分部资料

图表 2020-2021年英特尔收入分地区资料

图表 2021-2022年英特尔综合收益表

图表 2021-2022年英特尔分部资料

图表 2021-2022年英特尔收入分地区资料

图表 2022-2023年英特尔综合收益表

图表 2022-2023年英特尔分部资料

图表 2022-2023年英特尔收入分地区资料

图表 2020-2021年英伟达综合收益表

图表 2020-2021年英伟达分部资料

图表 2020-2021年英伟达收入分地区资料

图表 2021-2022年英伟达综合收益表

图表 2021-2022年英伟达分部资料

图表 2021-2022年英伟达收入分地区资料

图表 2022-2023年英伟达综合收益表

图表 2022-2023年英伟达分部资料

图表 2022-2023年英伟达收入分地区资料

图表 2020-2021年AMD综合收益表

图表 2020-2021年AMD分部资料

图表 2020-2021年AMD收入分地区资料

图表 2021-2022年AMD综合收益表

图表 2021-2022年AMD分部资料

图表 2021-2022年AMD收入分地区资料

图表 2022-2023年AMD综合收益表

图表 2022-2023年AMD分部资料

图表 2022-2023年AMD收入分地区资料

图表 2020-2021年联发科综合收益表

图表 2020-2021年联发科分部资料

图表 2020-2021年联发科收入分地区资料

图表 2021-2022年联发科综合收益表

图表 2021-2022年联发科分部资料

图表 2021-2022年联发科收入分地区资料

图表 2022-2023年联发科综合收益表

图表 2022-2023年联发科分部资料

图表 2022-2023年联发科收入分地区资料

图表 海思半导体主要产品

图表 紫光展锐主要产品

图表 2020-2023年光迅科技总资产及净资产规模

图表 2020-2023年光迅科技营业收入及增速

图表 2020-2023年光迅科技净利润及增速

图表 2022-2023年光迅科技营业收入/主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年光迅科技营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年光迅科技净资产收益率

图表 2020-2023年光迅科技短期偿债能力指标

图表 2020-2023年光迅科技资产负债率水平

图表 2020-2023年光迅科技运营能力指标

图表 2020-2023年寒武纪科技总资产及净资产规模

图表 2020-2023年寒武纪科技营业收入及增速

图表 2020-2023年寒武纪科技净利润及增速

图表 2022-2023年寒武纪科技营业收入/主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年寒武纪科技营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年寒武纪科技净资产收益率

图表 2020-2023年寒武纪科技短期偿债能力指标

图表 2020-2023年寒武纪科技资产负债率水平

图表 2020-2023年寒武纪科技运营能力指标

图表 2020-2023年盛景微电子总资产及净资产规模

图表 2020-2023年盛景微电子营业收入及增速

图表 2020-2023年盛景微电子净利润及增速

图表 2022-2023年盛景微电子营业收入/主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年盛景微电子营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年盛景微电子净资产收益率

图表 2020-2023年盛景微电子短期偿债能力指标

图表 2020-2023年盛景微电子资产负债率水平

图表 2020-2023年盛景微电子运营能力指标

图表 2020-2023年兆易创新总资产及净资产规模

图表 2020-2023年兆易创新营业收入及增速

图表 2020-2023年兆易创新净利润及增速

图表 2022-2023年兆易创新营业收入/主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年兆易创新营业利润及营业利润率

图表 2020-2023年兆易创新净资产收益率

图表 2020-2023年兆易创新短期偿债能力指标

图表 2020-2023年兆易创新资产负债率水平

图表 2020-2023年兆易创新运营能力指标

图表 中国大陆芯片企业数量